【茨城】半導体製造装置（ウェーハ面取り関連）のアプリケーションエンジニア

東京証券取引所プライム市場に上場・半導体製造装置と精密計測機器の製造販売

Job Information

Recruiter
GLOBAL RESEARCH INC.

Hiring Company
東京証券取引所プライム市場に上場・半導体製造装置と精密計測機器の製造販売

Job ID
1572973

Industry
Machinery

Company Type
Large Company (more than 300 employees)

Job Type
Permanent Full-time

Location
Ibaraki Prefecture, Tsuchiura-shi

Salary
6.5 million yen ~ 8 million yen

Holidays
完全週休2日制（土・日）、祝、年間休日128日

Refreshed
October 27th, 2026 15:00

General Requirements

Minimum Experience Level
Over 3 years

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Daily Conversation Level (Amount Used: English usage about 10%)

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【概要】
ウェーハ面取り機を使用した加工技術開発業務
具体的には、
・ウェーハ研削面取り機を使用し新しい加工プロセスの研削評価
・ウェーハ研削面取り装置を使用し加工提案・企画・加工プロセスの開発
・ウェーハ研削面取り装置を使用しお客様から依頼の面取り研削加工

【年俸】
645万円 ~ 795万円

【勤務地】
茨城県土浦市

Required Skills

【必要職務経験】
・Office系ソフト等のPC使用が行える方、かつ装置と加工工具を使用し加工評価の経験のある方

【歓迎職務経験】
・工学系（機械工学）出身の方
・研削装置を使用し研削評価の経験のある方
・英語での会話経験がある方

Company Description